

인공지능반도체 연계전공

Artificial Intelligence Semiconductor Joint Major Program

광운대학교 인공지능반도체 연계전공 과정은 교육부 및 과학기술정보통신부의 '인공지능반도체 융합인력양성사업'의 지원으로 설립되었습니다. 본 연계전공과정을 신청한 학생들은 각종 장학금, 산학협력프로젝트 참여, 연구실 인턴십 참여, 국내외 학술대회 참여 등의 혜택을 받을 수 있으며, 졸업시 인공지능반도체 연계전공 공학사 학위를 취득하게 됩니다.

교육목표

- 인공지능반도체 분야 회로설계 · 소자공정 · 시스템SW의 융합적 전문지식을 갖는 인재를 양성함.
- 인공지능반도체, 시스템반도체, 인공지능소프트웨어, 반도체 회로 및 시스템 분야에서 기술적 · 산업적 리더십을 발휘하는 엔지니어를 배출하는 것을 목표로 함

참여학과

전자정보공과대학 4개학과 (전자공학과, 전자통신공학과, 전자융합공학과, 전자재료공학과)
소프트웨어융합대학 1개학과 (컴퓨터정보공학부)

참여교수진

5개 참여학과 22명의 교수진

AI 디지털 회로 · 시스템 · 신호처리



정한울(전자) 김진영(전자융합) 오혁준(전자통신) 서영호(전자재료) 이성원(컴정공) 이준환(컴정공)

AI 아날로그 회로설계



신현철(전자융합) 김정근(전자) 어윤성(전자) 오태현(전자) 채주형(전자통신) 고승훈(전자재료)

데이터 · 소프트웨어



최영석(전자통신) 신동화(컴정공) 유지현(컴정공) 최상호(컴정공)

AI 소자 · 공정 · 융합



박하민(전자) 심준섭(전자융합) 김정현(전자융합) 조원주(전자재료) 이대석(전자재료) 하태준(전자재료)

대상학생

2학년 2학기(4학기) 이상 이수 또는 이수 예정자는 소속학과 상관 없이 누구나 신청가능

연계전공 이수요건

총 이수 학점 | 33 학점 이상

필수과목 | 인공지능반도체설계프로젝트(4학년 1학기 이수, 본 사업 참여교수님과 관련분야 설계프로젝트를 수행하고 및 결과를 발표함)

선택과목 | 30학점 이상

중복인정 | 소속전공 및 연계전공 간 15학점까지 중복 인정

수여학위 | 공학사 (인공지능반도체)

교과과정 편성표

학년	학기	인공지능반도체연계전공	전자공학과	전자통신공학과	전자융합공학과	전자재료공학과	컴퓨터정보공학부
2	1						
	2		· 컴퓨터구조		· 컴퓨터구조 · 데이터사이언스		
3	1		· 전자회로1 · 반도체소자및설계	· 전자회로1 · 컴퓨터구조 · 반도체공학	· 전자회로1 · 마이크로프로세서	· 전자회로1 · 시스템반도체설계	· 컴퓨터구조 · 시스템프로그래밍
	2		· 전자회로2 · 디지털집적회로서세	· 전자회로2 · 마이크로프로세서 · 데이터사이언스 · 시스템반도체설계	· 전자회로2 · 임베디드시스템	· 전자회로2	· 마이크로프로세서 · SW/HW통합설계 · 인공지능
4	1	· 인공지능반도체설계프로젝트	· 머신러닝 · 인공지능과음성신호처리		· 머신러닝 · 융합반도체공정 · 반도체집적회로설계	· 박막재료공학 · 집적회로설계	· AI시스템온칩설계및응용
	2			· 머신러닝 · 집적회로설계			· 인공지능프로그래밍

학생지원혜택

장학제도 | 참여학생을 대상으로 소정의 절차를 거쳐 학업장려장학금 지급

기타, 성적우수자 학업성취장학금, 학술논문발표 등에 따른 학술성취장학금, 대학원 연구실 인턴십참여에 따른 학업장려장학금 등 다양한 장학금 지원

교과외 활동 | 국내외 관련 학술대회 및 유명 전시회 (예, CES) 등 참여 기회 부여 (일정 기준에 따른 선발 예정)

학부연구생 지원, 산학협력프로젝트 참여 지원, 산학인턴십 지원

지도교수 책임지도 | 인공지능반도체분야 지도교수 매칭 및 학업/진로/연구 지도

신청일정

매 학기 초 수강신청 기간 중 KLAS 수강신청시스템을 통한 신청

연계전공 신청 학생 중 연계전공 교과목 이수요건에 따른 2학기 수강신청을 완료 하고 연계전공이수가 진행되고 있음을 증빙하여 장학금을 지급함

문의

인공지능반도체연계전공 사무실 (위치 : 비마관 204호, 전화 : 02-940-8488)

홈페이지 : <https://ei.kw.ac.kr> (광운대학교 전자정보공과대학 홈페이지)